

摘要

《SIDRA 国际争议解决调查：2024 年最终报告》（以下简称《报告》）中包含新加坡国际争议解决学院（SIDRA）主持的第三次国际争议解决调查的调查结果。SIDRA 调查是一项跨境国际调查，旨在研究企业和律师在国际争议解决中作出决定的方式和原因。《报告》揭示了国际争议解决用户对各类争议解决机制的满意度和相关经验，包括国际商事仲裁、国际商事调解、国际商事诉讼、混合型争议解决以及投资者-东道国争议解决。

本期《报告》包含两部分新内容：知识产权争议和技术争议。

以下将对《报告》所收集的数据进行概述：

国际商事仲裁

- 对于所有选择仲裁作为争议解决机制的受访者来说，直接可执行性和保密性仍然是最重要的考虑因素。
- 随着国际商事仲裁的对抗性的加强，客户和外部律师对商业关系的维系、客户业务产生的间接成本以及仲裁费用的满意度在降低。客户可能更加注重成本，而对程序缓慢的容忍度在降低。
- 受访者在决定是否使用完全在线平台进行仲裁时，首要考虑因素是旅行限制、低成本、低争议价值和低争议复杂度。
- 超过 70%的受访者了解第三方资助机制，及其影响和运作方式，但没有使用过。使用过第三方资助的受访者中，23%曾将其用于执行仲裁裁决。

国际商事调解

- 成本、速度和公正性是受访者决定使用国际商事调解以解决纠纷的三大重要因素。大多数受访者对这三大因素基本满意。相比于认为速度是重要因素，更多的受访者对速度因素感到满意。



- 大多数受访者认为，争议解决经验和良好的职业道德是选择调解员的两个最重要的因素。
- 大多数受访者选择在线平台进行调解的情况是：在线平台成本较低、存在旅行限制以及争议价值较低。外部律师表示，如果他们希望专家或证人出席，他们更倾向于在线调解。
- 受访者表示，种族、性别和年龄是他们希望在调解员选择上看到更多多元化的三大因素。然而，大多数受访者对选择调解员时多样性的重要性持中立态度。

国际商事诉讼

- 终局性是影响受访者选择国际商事诉讼作为争议解决机制的最重要因素。其他重要因素包括直接可执行性、公正性和速度。
- 对于客户业务产生的间接成本以及国际商事诉讼中专业争议解决人员/中立人士的可用性，较少的受访者感到满意。
- 相比于国际商事法庭，如伦敦商事法庭和新加坡国际商事法庭，更多受访者倾向于选择地方法院进行诉讼，以解决跨境商业纠纷。
- 大多数受访者表示，他们了解第三方资助在国际商事诉讼中的应用和运作方式，但尚未使用过。

混合型争议解决

- 受访者选择使用混合型争议解决机制的主要因素是合同义务、客户的要求和对方的要求。
- 受访者对于混合型争议解决机制的保密性、程序的灵活性、在选择机构、地点和争议解决专业人员上的灵活性、规则和程序的清晰度和透明度、商业关系的维系、公正性、透明度、直接可执行性和终局性方面，表示“非常满意”。
- 在混合型争议解决机制中，关于选择仲裁员或调解员的程序，受访者认为以下因素“绝对关键”或“重要”：成本、效率、来自第三方国家的仲裁员或调解员、特定行业/问题的专业知识、争议解决经验、正式资格、语言、良好的职业道德和文化熟



悉度。

投资者-国家争议解决

- 国际仲裁仍然是在解决投资者与国家间纠纷时首选的争议解决机制，大多数受访者选择机构仲裁或临时仲裁。
- 在选择解决投资者与国家间纠纷的争议解决机制时，最重要的考虑因素是规则和程序的清晰度和透明度，其次是直接可执行性和终局性。
- 受访者表示，增加专家队伍、允许采用调解和混合型程序，将改善投资者与国家间争议解决程序。
- 大多数受访者在投资者与国家间争议解决中没有使用过第三方资助，但了解其应用和运作方式。

知识产权争议

- 受访者普遍参与过商标和版权纠纷的争议解决。
- 在参与的知识产权纠纷中，他们一般会在知识产权纠纷正式程序（如仲裁和/或诉讼）开始之前而非程序开始之后达成和解。
- 诉讼是知识产权纠纷最常用且最受欢迎的争议解决机制。而仲裁是最不常用的争议解决机制之一，也是受访者最不喜欢的。
- 新加坡、英国和印度是受访者最多选择提起知识产权诉讼或作出辩护的司法管辖区。

技术争议

- 大多数受访者参与过信息技术纠纷，其次是数据或系统泄露纠纷。
- 受访者最常用的解决技术纠纷的争议解决机制是调解，但他们最倾向于使用的是诉讼。
- 在选择解决技术纠纷的争议解决机制时，成本和速度是受访者最重视的因素。
- 大多数受访者表示，他们在一定程度上同意技术纠纷中可供选择的争议解决专业



人员的多样性有限的说法。

The Chinese version of the Executive Summary of the SIDRA International Dispute Resolution Survey: 2024 Final Report has been provided by **Yueming Yan** (Assistant Professor, Chinese University of Hong Kong) and **Chunshui E** (LLM, Chinese University of Hong Kong).

